# 2024-2029年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告

# 目 录

#### **CONTENTS**

## ——综述篇——

#### 第1章: 芯片行业综述及数据来源说明

- 1.1 芯片行业界定
  - 1.1.1 芯片的界定
  - 1.1.2 芯片相似概念辨析
  - 1.1.3《国民经济行业分类与代码》中芯片行业归属
- 1.2 芯片行业分类
  - 1.2.1 按国际标准分类
  - 1.2.2 按使用功能分类
- 1.3 芯片行业监管体系及机构介绍
  - 1.3.1 中国芯片行业主管部门
  - 1.3.2 中国芯片行业自律组织
- 1.4 芯片产业画像
  - 1.4.1 芯片产业链结构梳理
  - 1.4.2 芯片产业链生态图谱
  - 1.4.3 芯片产业链区域热力图
- 1.5 芯片专业术语说明
- 1.6 本报告研究范围界定说明
- 1.7 本报告数据来源及统计标准说明
  - 1.7.1 本报告权威数据来源
  - 1.7.2 本报告研究方法及统计标准说明

#### **——现状篇—**—

#### 第2章:全球芯片行业发展状况分析

- 2.1 全球芯片行业发展历程
- 2.2 全球芯片市场发展现状分析
  - 2.2.1 全球芯片市场供给现状
  - 2.2.2 全球芯片市场需求现状
  - 2.2.3 全球芯片市场发展特点
- 2.3 全球芯片行业市场规模体量
  - 2.3.1 全球半导体行业市场规模
  - 2.3.2 全球芯片行业市场规模
- 2.4 全球芯片行业市场竞争格局
- 2.5 全球芯片行业区域发展格局及重点区域市场研究
  - 2.5.1 全球芯片行业区域发展格局
  - 2.5.2 重点区域一:美国芯片行业市场分析
    - 1、美国芯片市场规模
    - 2、美国芯片技术研发进展
  - 2.5.3 重点区域二: 韩国芯片行业市场分析
    - 1、韩国芯片市场规模
    - 2、韩国芯片技术研发进展

#### 2.6 全球芯片行业发展趋势预判及市场前景预测

- 2.6.1 中美贸易战对全球芯片行业发展影响分析
  - 1、中美贸易战对全球芯片行业供应链结构产生的影响
  - 2、中美贸易战对全球芯片价值链重构产生的影响
- 2.6.2 全球芯片行业发展趋势预判
- 2.6.3 全球芯片行业市场前景预测

### 第3章:中国芯片行业发展状况分析

- 3.1 中国芯片行业发展综述
  - 3.1.1 中国芯片产业发展历程
  - 3.1.2 中国芯片行业发展地位
- 3.2 中国芯片行业市场主体

- 3.2.1 芯片市场主体类型
- 3.2.2 芯片企业进场方式
- 3.2.3 芯片新注册企业
- 3.2.4 芯片在业/存续企业
  - 1、芯片行业企业注册资本分布
  - 2、芯片行业注册企业省市分布
  - 3、芯片行业在业/存续企业类型分布
- 3.3 中国芯片行业经营模式
- 3.4 中国芯片市场供给情况
  - 3.4.1 中国芯片产能现状
  - 3.4.2 中国芯片产量现状
- 3.5 中国芯片行业需求情况
- 3.6 中国芯片产业进出口贸易情况
  - 3.6.1 中国集成电路(芯片)行业进出口贸易概况
  - 3.6.2 中国集成电路(芯片)行业进口贸易状况
    - 1、集成电路(芯片)行业进口贸易规模
    - 2、集成电路(芯片)行业进口价格水平
    - 3、集成电路(芯片)行业进口产品结构
  - 4、集成电路(芯片)行业进口来源地
  - 3.6.3 中国集成电路(芯片)行业出口贸易状况
    - 1、集成电路(芯片)行业出口贸易规模 2、集成电路(芯片)行业出口价格水平

    - 3、集成电路(芯片)行业出口产品结构 4、集成电路(芯片)行业出口目的地

  - 3.6.4 中国集成电路(芯片)行业进出口贸易影响因素及发展趋势
- 3.7 中国芯片行业市场规模(除港澳台)
- 3.8 中国芯片产业痛点与应对策略
  - 3.8.1 中国芯片产业痛点分析
  - 3.8.2 中国芯片产业痛点应对策略

#### 第4章:中国芯片行业技术研发及资本动向

- 4.1 中国芯片行业标准体系建设现状
  - 4.1.1 中国芯片行业标准体系建设
  - 4.1.2 中国芯片行业现行标准分析
    - 1、中国芯片行业现行国家标准汇总 2、中国芯片行业现行行业标准汇总
    - 3、中国芯片行业现行地方标准汇总
    - 4、中国芯片行业现行企业标准汇总
    - 5、中国芯片行业现行团体标准汇总
  - 4.1.3 中国芯片行业重点标准解读
- 4.2 中国芯片行业国家投资水平
- 4.3 中国芯片研发投入&产出
  - 4.3.1 中国芯片研发投入情况
    - 1、研发投入力度
    - 2、研发投入强度
    - 3、研发人员数量
  - 4.3.2 中国芯片科研产出-文献
    - 1、文献数量
    - 2、文献主题
    - 3、发表机构
  - 4.3.3 中国芯片科研产出-专利
    - 1、专利数量
      - (1) 专利申请数量
      - (2) 专利公开数量
    - 2、热门技术
    - 3、主要机构
  - 4.3.4 中国芯片技术创新动态
    - 1、基于自研架构的国产处理器-龙芯3A6000
    - 2、AI芯片领域-光电子卷积处理器
- 4.4 中国芯片行业技术工艺及流程

#### 4.5 中国芯片技术路线图/全景图

- 4.6 中国芯片技术布局动态
  - 4.6.1 技术创新主流模式
  - 4.6.2 关键核心技术
    - 1、EDA软件的开发 2、光刻技术
  - 4.6.3 新兴技术融合发展
  - 4.6.4 技术研发方向/趋势

## 4.7 中国芯片行业投融资动态及热门赛道

- 4.7.1 芯片行业融资动态
  - 1、资金来源
  - 2、融资事件
  - 3、融资规模
  - 4、融资轮次
  - 5、热门融资赛道
  - 6、热门融资地区
- 4.7.2 芯片行业对外投资

#### 4.8 芯片行业兼并重组动态

- 4.8.1 兼并重组阶段、方式及动因
- 4.8.2 兼并重组事件
- 4.8.3 兼并重组案例
- 4.8.4 兼并重组趋势

#### 4.9 中国芯片企业IPO动态

- 4.9.1 中国芯片行业IPO企业汇总
- 4.9.2 中国芯片行业IPO动态追踪
- 4.9.3 IPO募资规模
- 4.9.4 IPO板块分布
- 4.9.5 IPO企业地域分布
- 4.9.6 行业IPO展望

#### 第5章:中国芯片行业竞争格局及竞争态势

- 5.1 芯片竞争者入场及布局态势
  - 5.1.1 芯片竞争者入场动因
  - 5.1.2 芯片竞争者入场进程
  - 5.1.3 芯片竞争者集群/梯队
- 5.2 中国芯片行业企业竞争格局
- 5.3 中国芯片行业市场竞争程度
  - 5.3.1 芯片行业市场集中度 5.3.2 芯片行业波特五力分析
- 5.4 芯片海外企业在华市场竞争
  - 5.4.1 海外企业在华市场竞争策略
  - 5.4.2 海外企业在华市场竞争力评价
- 5.5 中国芯片领先企业核心竞争力解构
  - 5.5.1 芯片企业竞争路线/焦点汇总
  - 5.5.2 芯片领先企业成功关键因素(KSF)
  - 5.5.3 芯片领先企业竞争力雷达图
- 5.6 中国芯片企业全球化布局及竞争力
  - 5.6.1 中国芯片企业出海/全球化布局
  - 5.6.2 中国芯片企业在全球市场竞争力评价
  - 5.6.3 中国芯片企业全球化布局策略
- 5.7 中国芯片行业国产替代布局状况
  - 5.7.1 中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况
  - 5.7.2 中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况

### 第6章:中国芯片领域细分行业分析

- 6.1 中国芯片设计行业发展分析
  - 6.1.1 中国芯片设计行业发展历程
  - 6.1.2 中国芯片设计行业市场现状
    - 1、企业数量
    - 2、市场规模
  - 6.1.3 中国芯片设计行业竞争格局

### 6.2 中国芯片制造行业发展分析

- 6.2.1 芯片技术现状
- 6.2.2 中国芯片制造市场现状
  - 1、晶圆代工产能规模
  - 2、市场规模
- 6.2.3 中国晶圆制造行业竞争格局

#### 6.3 中国芯片封测行业发展分析

- 6.3.1 芯片封测技术
  - 1、芯片封装技术简介
  - 2、芯片测试技术简介
- 6.3.2 中国芯片封测行业市场现状
  - 1、主要企业产量
  - 2、市场规模
- 6.3.3 中国芯片封测行业竞争格局

#### 第7章:中国芯片行业细分产品分析

- 7.1 芯片行业产品结构概况
  - 7.1.1 芯片产品类型介绍
  - 7.1.2 芯片产品结构分析
- 7.2 中国模拟芯片市场分析
  - 7.2.1 模拟芯片概况
    - 1、模拟芯片概况
    - 2、模拟芯片分类
  - 7.2.2 模拟芯片市场规模
    - 1、全球模拟芯片市场规模
    - 2、中国模拟芯片市场规模
  - 7.2.3 模拟芯片市场竞争格局
    - 1、全球模拟芯片竞争格局
    - 2、中国模拟芯片竞争格局
  - 7.2.4 模拟芯片的下游应用

## 7.3 中国微处理器市场分析

- 7.3.1 微处理器分类
- 7.3.2 微处理器市场规模
  - 1、全球微处理器市场规模
  - 2、中国微处理器市场规模
- 7.3.3 微处理器市场竞争格局
  - 1、全球微处理器的竞争格局 2、中国微处理器的竞争格局
- 7.3.4 微处理器的下游应用

## 7.4 中国逻辑芯片市场分析

- 7.4.1 逻辑芯片分类
- 7.4.2 逻辑芯片市场规模
  - 1、全球逻辑芯片市场规模
  - 2、中国逻辑芯片市场规模
- 7.4.3 逻辑芯片市场竞争格局
  - 1、计算机处理器(CPU)市场竞争格局
  - 2、计算机图形处理器 (GPU) 市场竞争格局
- 7.4.4 逻辑芯片的下游应用

#### 7.5 中国存储器市场分析

- 7.5.1 存储器分类
- 7.5.2 存储器市场规模
  - 1、全球存储器市场规模
  - 2、中国存储器市场规模
- 7.5.3 存储器市场竞争格局
  - 1、细分产品竞争格局
  - 2、企业竞争格局
- 7.5.4 存储器的下游应用

## 7.6 中国芯片行业未来细分产品——量子芯片发展进程分析

- 7.6.1 量子芯片概述
- 7.6.2 产品发展历程

- 7.6.3 市场发展形势
- 7.6.4 产品研发动态

#### 第8章:中国芯片产业价值链及供应链分析

- 8.1 中国芯片价值链——产业价值属性分析
  - 8.1.1 芯片行业成本投入结构
  - 8.1.2 芯片行业价格传导机制
  - 8.1.3 芯片行业价值链分析图
- 8.2 中国芯片原材料市场分析
  - 8.2.1 芯片原材料概述
  - 8.2.2 中国半导体材料市场分析
  - 8.2.3 中国硅片市场分析
  - 8.2.4 中国光刻胶市场分析
  - 8.2.5 中国CMP抛光液市场分析
  - 8.2.6 中国芯片原材料发展趋势

#### 8.3 中国芯片关键设备市场分析

- 8.3.1 芯片关键设备概述
- 8.3.2 中国半导体设备市场分析
- 8.3.3 中国光刻机市场分析
- 8.3.4 中国刻蚀设备市场分析
- 8.3.5 中国薄膜沉积设备市场分析
- 8.3.6 中国芯片核心设备发展趋势

#### 8.4 中国芯片其他相关配套产业市场分析

- 8.4.1 中国芯片算法市场分析
- 8.4.2 中国芯片IP分析
- 8.4.3 中国芯片EDA工具分析
- 8.5 配套产业布局对芯片行业的影响总结

#### 第9章:中国芯片下游应用市场分析

- 9.1 中国5G芯片发展现状
  - 9.1.1 5G产业发展背景
  - 9.1.2 5G芯片市场发展现状
  - 9.1.3 5G芯片市场竞争格局
  - 9.1.4 5G芯片发展趋势

#### 9.2 中国自动驾驶芯片发展现状

- 9.2.1 自动驾驶行业发展背景
- 9.2.2 自动驾驶芯片市场发展现状
- 9.2.3 自动驾驶芯片市场竞争格局
- 9.2.4 自动驾驶芯片发展前景

#### 9.3 中国AI芯片发展现状

- 9.3.1 AI产业发展背景
- 9.3.2 AI芯片市场发展现状
- 9.3.3 AI芯片市场竞争格局
- 9.3.4 AI芯片发展趋势

## 9.4 中国智能穿戴设备芯片发展现状

- 9.4.1 智能穿戴设备行业发展背景
- 9.4.2 智能穿戴设备芯片市场发展现状
- 9.4.3 智能穿戴设备芯片市场竞争格局
- 9.4.4 智能穿戴设备芯片发展趋势

#### 9.5 中国智能手机芯片发展现状

- 9.5.1 智能手机行业发展背景
- 9.5.2 智能手机芯片市场发展现状
- 9.5.3 智能手机芯片市场竞争格局
- 9.5.4 智能手机芯片发展趋势

### 9.6 中国服务器芯片发展现状

- 9.6.1 服务器行业发展背景
- 9.6.2 服务器芯片市场发展现状
- 9.6.3 服务器芯片市场竞争格局
- 9.6.4 服务器芯片发展趋势

#### 9.7 中国个人计算机芯片发展现状

9.7.1 个人计算机行业发展背景

- 9.7.2 个人计算机芯片市场发展现状
  - 1、计算机CPU芯片发展现状
  - 2、计算机GPU芯片发展现状
- 9.7.3 个人计算机芯片市场竞争格局
  - 1、计算机CPU芯片竞争格局
  - 2、计算机GPU芯片竞争格局
- 9.7.4 个人计算机芯片发展趋势

#### 第10章:中国芯片产业区域发展格局解读

- 10.1 中国芯片行业区域发展格局
  - 10.1.1 中国芯片行业企业区域分布
  - 10.1.2 中国芯片行业产量区域分布
- 10.2 中国芯片产业集群/园区建设现状
- 10.3 重点区域发展状况:深圳
  - 10.3.1 芯片行业发展环境
  - 10.3.2 芯片行业发展现状
    - 1、芯片行业企业数量
    - 2、芯片行业市场规模
  - 10.3.3 芯片行业细分领域现状
    - 1、IC设计环节
    - 2、IC制造环节
    - 3、IC封测环节
  - 10.3.4 芯片行业发展趋势

#### 10.4 重点区域发展状况:上海

- 10.4.1 芯片行业发展环境
- 10.4.2 芯片行业发展现状
  - 1、芯片行业企业数量
  - 2、芯片行业市场规模
- 10.4.3 芯片行业细分领域现状
  - 1、IC设计环节
  - 2、IC制造环节
  - 3、IC封测环节
- 10.4.4 芯片行业发展趋势

#### 10.5 重点区域发展状况:台湾

- 10.5.1 芯片行业发展环境
- 10.5.2 芯片行业发展现状
  - 1、芯片行业市场规模
- 10.5.3 芯片行业细分领域现状
  - 1、IC设计环节
  - 2、IC制造环节
  - 3、IC封测环节
- 10.5.4 芯片技术研发进展
- 10.5.5 芯片行业发展趋势

#### 第11章:全球及中国芯片企业案例解析

- 11.1 芯片综合型企业案例分析
  - 11.1.1 英特尔
    - 1、企业基本信息
    - 2、经营效益分析
    - 3、企业产品结构
    - 4、技术工艺开发
    - 5、未来发展战略
  - 11.1.2 三星
    - 1、企业基本信息
    - 2、经营效益分析
    - 3、企业产品结构
    - 4、芯片行业发展
    - 5、技术工艺开发
  - 6、未来发展战略 11.1.3 高通公司
    - 1、企业基本信息

- 2、经营效益分析
- 3、企业业务结构
- 4、技术工艺开发
- 5、未来发展战略
- 11.1.4 英伟达
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业业务结构
  - 4、技术工艺开发
  - 5、未来发展战略
- 11.1.5 AMD
  - 1、企业发展概况
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业业务结构
  - 4、技术工艺开发
  - 5、未来发展战略
- 11.1.6 SK海力士
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
  - 4、芯片行业发展
  - 5、未来发展战略
- 11.1.7 德州仪器
  - 1、企业发展概况
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
  - 4、企业区域分布
  - 5、未来发展战略
- 11.1.8 联发科技
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
  - 4、企业销售区域分布
  - 5、技术工艺开发
  - 6、未来发展战略

#### 11.2 芯片设计重点企业案例分析

- 11.2.1 海思
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
  - 4、技术工艺开发
  - 5、最新发展动态
- 11.2.2 博通有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
- 4、收购动态分析
- 11.2.3 Marvell
  - 1、企业发展概况
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业产品结构
  - 4、未来发展战略
- 11.2.4 赛灵思
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业产品结构
  - 3、收购动态分析
- 11.2.5 紫光展锐
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析

- 3、产品研发进展
- 4、收购动态分析

#### 11.3 晶圆代工重点企业案例分析

- 11.3.1 台积电
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、公司晶圆代工业务
  - 4、产品研发进展
  - 5、技术工艺开发
  - 6、企业发展战略
- 11.3.2 格芯
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、晶圆代工业务
  - 4、技术工艺开发
  - 5、企业发展战略
- 11.3.3 联电
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、晶圆代工业务
  - 4、技术工艺开发
  - 5、未来发展战略
- 11.3.4 力积电
  - 1、企业基本信息
  - 2、经营效益分析
  - 3、晶圆代工业务
  - 4、技术工艺开发
- 11.3.5 中芯国际
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况分析
  - 3、企业产品结构分析
  - 4、企业晶圆代工业务分析
  - 5、企业技术水平分析
  - 6、企业营销网络分析
  - 7、企业发展战略
- 11.3.6 华虹
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况分析
  - 3、企业产品结构分析
  - 4、企业营销网络分析
  - 5、企业技术水平分析

## 11.4 芯片封测重点企业案例分析

- 11.4.1 Amkor
  - 1、企业发展简介
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业销售区域分布
  - 4、企业在中国市场投资布局情况
- 11.4.2 日月光
  - 1、企业发展简介
  - 2、企业财务情况分析
  - 3、企业主营产品及应用领域
  - 4、企业产能布局
- 11.4.3 南茂
  - 1、企业发展概况
  - 2、经营效益分析
  - 3、企业业务结构
  - 4、企业营销网络分析
- 11.4.4 长电科技
  - 1、企业基本信息

- 2、企业经营情况分析
- 3、企业产品结构分析
- 4、企业营销网络分析
- 5、企业技术水平分析
- 11.4.5 天水华天
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况分析
  - 3、企业产品结构分析
  - 4、企业技术水平分析
  - 5、企业营销网络分析
- 11.4.6 通富微电
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况分析
  - 3、企业产品结构分析
  - 4、企业产能布局及营销网络分析

## ——展望篇—-

## 第12章:中国芯片行业政策环境洞察&发展潜力

- 12.1 中国芯片行业政策 (Policy) 环境分析
  - 12.1.1 国家层面芯片行业政策规划汇总及解读
  - 12.1.2 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析
    - 1、工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》对芯片行业发展的影
    - 2、《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》对芯片行业发展的影响
  - 12.1.3 中国芯片行业区域政策热力图
  - 12.1.4 中国芯片产业各省市政策汇总及解读
    - 1、中国芯片产业各省市重点政策汇总
    - 2、中国各省市芯片行业发展目标解读
  - 12.1.5 政策环境对行业发展的影响分析
- 12.2 中国芯片行业SWOT分析(优势/劣势/机会/威胁)
- 12.3 中国芯片行业发展潜力评估

## 第13章:中国芯片行业市场前景及发展趋势洞悉

- 13.1 中国芯片行业未来关键增长点
  - 13.1.1 细分产品关键增长点
    - 1、人工智能芯片
    - 2、边缘计算芯片
    - 3、量子计算芯片
    - 4、物联网芯片
    - 5、高性能计算芯片
  - 13.1.2 下游应用关键增长点
    - 1、通信领域
    - 2、工业控制
    - 3、汽车电子
  - 13.1.3 政策规划下的关键增长点
- 13.2 中国芯片行业发展前景预测
  - 13.2.1 芯片总体前景预测
  - 13.2.2 芯片细分领域前景预测
- 13.3 中国芯片行业发展趋势洞悉
  - 13.3.1 芯片行业技术发展趋势
  - 13.3.2 行业产品发展趋势预测
  - 13.3.3 行业市场竞争趋势预测

#### 第14章:中国芯片行业投资战略规划策略及建议

- 14.1 中国芯片行业进入与退出壁垒
  - 14.1.1 进入壁垒
    - 1、技术壁垒
    - 2、人才壁垒
    - 3、资金实力壁垒
    - 4、产业化壁垒
    - 5、客户维护壁垒
  - 14.1.2 退出壁垒

响

### 14.2 中国芯片行业投资风险预警

- 14.2.1 风险预警
  - 1、政策风险
  - 2、宏观经济风险
  - 3、供求风险
  - 4、其他风险
- 14.2.2 风险应对

#### 14.3 中国芯片行业投资机会分析

- 14.3.1 芯片产业链薄弱环节投资机会
- 14.3.2 芯片行业细分领域投资机会
  - 1、自动驾驶
  - 2、卫星通话终端
- 14.3.3 芯片行业区域市场投资机会
- 14.3.4 芯片产业空白点投资机会
  - 1、Chiplet技术的发展
  - 2、芯片的存算一体化发展

#### 14.4 中国芯片行业投资价值评估

- 14.4.1 芯片行业发展空间较大
- 14.4.2 芯片行业政策扶持利好
- 14.4.3 芯片下游应用市场增长迅速
- 14.5 中国芯片行业投资策略建议
- 14.6 中国芯片行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1: 芯片示意图
- 图表2: 半导体、芯片和集成电路概念区分
- 图表3:《国民经济行业分类(2017版)》中芯片行业所归属类别
- 图表4: 按电路对芯片进行分类
- 图表5: 不同功能的芯片介绍
- 图表6: 中国芯片行业监管体系构成
- 图表7: 中国芯片行业主管部门
- 图表8: 中国芯片行业自律组织
- 图表9: 芯片产业链结构梳理
- 图表10: 芯片产业链生态图谱
- 图表11: 芯片产业链区域热力图
- 图表12: 芯片专业术语说明
- 图表13: 本报告研究范围界定
- 图表14: 本报告权威数据资料来源汇总
- 图表15: 本报告的主要研究方法及统计标准说明
- 图表16: 全球芯片行业发展历程
- 图表17: 全球主要半导体厂商芯片产能排名(单位: 万片,%)
- 图表18: 2017-2022年全球芯片出货量(单位: 亿片, %)
- 图表19: 全球芯片市场特点分析
- 图表20: 2017-2022年全球半导体市场规模及增速(单位: 亿美元,%)
- 图表21: 2022年全球半导体细分产品结构(单位: 亿美元,%)
- 图表22: 2017-2022年全球集成电路(芯片)市场规模(单位:亿美元,%)
- 图表23: 2022年全球芯片细分产品结构(单位: 亿美元,%)
- 图表24: 2021-2022年全球主要半导体厂商业务收入排名(单位: 亿美元,%)
- 图表25: 2022年全球区域半导体市场竞争结构(单位:%)
- 图表26:2022年全球集成电路(芯片)区域市场分布(按企业所在地营收份额)(单位:%)
- 图表27: 2022年全球TOP20半导体厂商分布(不含纯代工厂)(单位: %)
- 图表28: 2017-2022年美国半导体及芯片市场规模(单位: 亿美元)
- 图表29: 2017-2022年韩国半导体行业市场规模(单位:亿美元,%)
- 图表30: 全球芯片行业发展趋势预判
- 图表31: 2023-2028年全球芯片行业市场规模预测(单位: 亿美元)

- 图表32: 中国芯片行业历程
- 图表33: 2018-2022年中国数字经济规模占GDP比重(单位:%)
- 图表34: 中国芯片行业主体构成
- 图表35: 中国芯片行业主体构成
- 图表36:中国芯片市场主体数量(单位:家)
- 图表37:2023年中国芯片企业注册资本分布(单位:家)
- 图表38: 2023年中国芯片企业省市分布(单位: 家,%)
- 图表39: 2023年中国芯片市场在业/存续企业类型分布(单位: 家,%)
- 图表40: 半导体产业链及业务模式
- 图表41:垂直分工商业模式
- 图表42: Foundry (代工厂) 模式分析
- 图表43: IDM (Integrated Device Manufacture) 模式分析
- 图表44: Fabless (无工厂芯片供应商)模式分析
- 图表45: 2022-2023年中国芯片行业代表性厂商产能情况
- 图表46: 2010-2022年中国集成电路(芯片)产量(单位: 亿块,%)
- 图表47: 2022年中国芯片行业代表性企业营收与销量情况(单位: 亿元, 亿片)
- 图表48:中国集成电路(芯片)行业进出口商品名称及HS编码
- 图表49:2018-2023年中国集成电路(芯片)行业进出口贸易概况(单位:亿元)
- 图表50: 2018-2023年中国集成电路(芯片)行业进口贸易状况(单位:亿个,亿元)
- 图表51: 2018-2023年中国集成电路(芯片)行业进口价格水平(单位:元/个)
- 图表52: 2022年中国集成电路(芯片)行业进口产品结构(单位:%)
- 图表53: 2022年中国集成电路(芯片)行业进口来源地情况(按金额统计)(单位: %)
- 图表54: 2018-2023年中国集成电路(芯片)行业出口贸易状况(单位:亿个,亿元)
- 图表55: 2018-2023年中国集成电路(芯片)行业出口价格水平(单位:元/个)
- 图表56: 2022年中国集成电路(芯片)行业出口产品结构(单位: %)
- 图表57: 2018-2023年中国集成电路(芯片)行业出口目的地情况(按金额)(单位:%)
- 图表58:中国集成电路(芯片)行业进出口贸易影响因素及发展趋势分析
- 图表59: 2013-2022年中国集成电路(芯片)市场销售额(单位:亿元,%)
- 图表60: 2015-2022年中国集成电路(芯片)各领域市场结构(单位:%)
- 图表61: 中国芯片产业痛点梳理
- 图表62: 中国芯片产业应对策略
- 图表63: 截至2023年中国芯片行业标准体系建设(单位:项)
- 图表64: 截至2023年中国芯片行业代表性现行国家标准
- 图表65: 截至2023年中国芯片行业的行业标准
- 图表66: 截至2023年中国芯片行业代表性地方标准
- 图表67: 2017-2023年发布的中国芯片行业的企业标准
- 图表68: 截至2023年中国芯片行业的团体标准
- 图表69: 中国芯片行业重点标准解读
- 图表70: 芯片产业基金投资动向统计
- 图表71: 国家芯片产业基金一期部分重点投资企业汇总
- 图表72: 国家芯片产业基金二期部分重点投资企业汇总
- 图表73:2018-2022年中国芯片行业研发投入力度(规模)(单位:亿元)
- 图表74: 2018-2022年中国芯片行业研发投入强度(占比)(单位:%)
- 图表75: 2018-2022年中国芯片行业研发人员数量及占比(单位:人,%)
- 图表76: 2014-2023年中国芯片行业文献数量(单位: 万篇)
- 图表77: 2023年中国芯片行业文献主题及数量汇总(Top10)(单位: 篇)
- 图表78: 2023年中国芯片行业发表机构及数量汇总(Top10)(单位:篇)
- 图表79: 2004-2023年中国芯片行业相关专利申请数量变化图(单位:项)
- 图表80: 2004-2023年中国芯片行业相关专利公开数量变化图(单位:项)
- 图表81: 截至2023年中国芯片行业热门技术
- 图表82: 截至2023年中国芯片企业专利排行榜(单位:项)
- 图表83: 芯片制作过程介绍
- 图表84: 中国芯片技术全景图
- 图表85: 中国芯片行业技术创新主流模式
- 图表86: 芯片行业的新兴技术分析
- 图表87: 芯片行业技术研发趋势
- 图表88: 中国芯片行业资金来源
- 图表89: 中国芯片行业重要资金来源解读
- 图表90: 2023年中国芯片行业投融资事件汇总

- 图表91:2001-2023年中国芯片行业融资规模(单位:起,亿元)
- 图表92: 截至2023年芯片行业融资轮次(单位:起,%)
- 图表93: 截至2023年中国芯片行业热门融资赛道(单位:起,%)
- 图表94: 芯片行业热门融资地区
- 图表95: 2023年中国芯片企业代表性投资事件/项目
- 图表96: 芯片行业兼并重组阶段、方式及动因
- 图表97: 2022-2023年兼并与重组事件汇总(单位: 亿元)
- 图表98: 2022-2023年中国芯片行业IPO企业汇总
- 图表99: 2022-2023年中国芯片行业IPO排队情况汇总
- 图表100: 2015-2023年中国芯片行业IPO规模情况(单位: 家, 亿元)
- 图表101: 2015-2023年中国芯片行业IPO板块分布情况(单位:家,%)
- 图表102: 2015-2023年中国芯片行业IPO企业区域分布情况(单位: 家,%)
- 图表103: 中国芯片行业IPO展望
- 图表104: 中国代表性芯片行业竞争者入场进程
- 图表105: 中国芯片行业竞争者集群
- 图表106: 2022年中国芯片行业代表性企业竞争分析(单位: 亿元, 亿片, %)
- 图表107:2022年中国芯片行业市场集中度(单位:%)
- 图表108: 芯片行业波特五力模型分析
- 图表109: 海外企业在中国的竞争策略分析
- 图表110: 海外企业在华市场竞争力评价
- 图表111: 芯片企业竞争路线/焦点汇总
- 图表112: 中国芯片行业领先企业成功关键因素分析
- 图表113: 中国芯片行业领先企业竞争力雷达图
- 图表114: 中国芯片企业全球化布局策略
- 图表115: 中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况
- 图表116: 中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况
- 图表117:2014-2022年中国IC设计行业企业数量(单位:家)
- 图表118: 2015-2022年中国芯片设计业销售额(单位: 亿元,%)
- 图表119: 2018-2022年国内TOP10芯片设计企业上榜门槛(单位:亿元)
- 图表120: 2022年中国芯片设计公司TOP20 (Fabless+IDM)
- 略•••完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容,请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务!